



平成 27 年 3 月 3 日

各 位

会社名 株式会社 S U M C O
代表者名 取締役社長 橋本 眞幸
(コード： 3 4 3 6 東証第一部)
問合せ先 広報・IR室長 澁谷 博史
(TEL. 03-5444-3915)

第三者割当による種類株式発行に関する資金使途変更のお知らせ

当社は、平成 24 年 3 月 8 日付「第三者割当による種類株式の発行に関するお知らせ」にて開示いたしました種類株式の発行に関する調達資金の使途につきまして、下記のとおり変更することといたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 変更の理由及び内容

当社は平成 27 年 3 月 3 日付当社プレスリリース「新株式発行に係る発行登録及び株式売出し実施予定、資本準備金の額の減少及び新株式発行と同時の資本金の額・資本準備金の額の減少、並びに自己株式（B 種種類株式）の取得（会社法第 156 条に基づく自己株式の取得）に関するお知らせ」の通り、本日開催の取締役会において、事業再生計画後の新たな成長ステージの指針である「新中期経営戦略」、並びに当社普通株式の発行、当社種類株式の取得による財務基盤の強化及び成長資金の確保を軸とした「資本増強・資本再構築プラン」（以下「本プラン」といいます。）について決議いたしました。

また、当社の A 種種類株式を保有する新日鐵住金株式会社、三菱マテリアル株式会社及びジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第 1 号投資事業有限責任組合（以下「A 種種類株主 3 者」といいます。）と本日付にて「種類株式の処理に関する覚書」（以下「本覚書」といいます。）を締結いたしました。本覚書に従い、当社は、A 種種類株式の処理、並びに A 種種類株主 3 者による金銭及び B 種種類株式を対価とする A 種種類株式に係る取得請求権の行使に伴い当社が A 種種類株主 3 者に対して交付する B 種種類株式の処理に向けた手続を行う予定です。

種類株式発行による手取概算額 44,700 百万円について、支出予定であった平成 27 年 1 月 31 日までの充当状況は以下のとおりです。当社グループでは平成 24 年度に開始した事業再生計画に基づき、ソーラー用シリコンウェーハ事業からの撤退、半導体用シリコンウェーハ事業の生産拠点の再編と集約並びに生産体制再構築に伴う要員体制の見直し等の諸施策を着実に実施し、固定費の圧縮及び収益力の強化に努めてまいりました。然しながら、事業再生計画策定以降、事業環境が事業再生計画策定時の想定を下回る状況が続いたため、財務安定性の維持を優先し、不急と判断できる設備投資及び研究開発投資等を削減したことから、13,832 百万円が未充当となっております。かかる未充当金の使途については本プランと併せて検討をいたしましたことから、本プランを決議しました本日付にてその充当先を決定し、A 種種類株主 3 者が平成 27 年 5 月 11 日に金銭及び B 種種類株式を対価とする

取得請求権を行使することに伴い交付される金銭の一部に充当することといたしました。

【変更前】

(単位：百万円)

具体的な用途	支出予定金額	支出予定時期
① 更なる競争力の向上に向けた半導体用シリコンウェーハの高精度化対応投資及び研究開発投資、等	14,100	平成24年6月～平成27年1月
② 事業用資産（ウェーハ生産設備等）の維持更新に係る設備投資	19,100	平成24年6月～平成27年1月
③ 営業活動の運転資金	11,500	平成24年6月～平成27年1月
合計	44,700	

※調達資金を実際に支出するまでは、銀行口座にて管理いたします。

【変更後】

(単位：百万円)

具体的な用途	充当金額	支出時期
① 更なる競争力の向上に向けた半導体用シリコンウェーハの高精度化対応投資及び研究開発投資、等	<u>11,438</u>	平成24年6月～平成27年1月
② 事業用資産（ウェーハ生産設備等）の維持更新に係る設備投資	<u>7,930</u>	平成24年6月～平成27年1月
③ 営業活動の運転資金	11,500	平成24年6月～平成27年1月
④ <u>A種種類株式の取得請求権行使に伴い交付される金銭の一部</u>	<u>13,832</u> <u>(予定)</u>	<u>平成27年5月</u> <u>(予定)</u>
合計	44,700	

※調達資金を実際に支出するまでは、銀行口座にて管理いたします。

(注) 充当金額は平成27年1月31日までの実績です。

2. 業績への影響

本件変更に伴う当社及び当社連結業績への影響は軽微であります。

平成27年12月期 第1四半期の連結業績予想につきましては、平成27年2月12日付で公表いたしました「平成26年12月期 決算短信」をご参照ください。

以上

ご注意：本資料は、第三者割当による種類株式発行に関する資金使途の変更に関し、一般の株主及び投資家に対する情報提供を目的に作成されたものであり、日本を含むいかなる法域においても、当社が発行する証券の勧誘を構成するものではありません。本資料に記載された予測、予想、見込みその他の将来情報は、当日現在当社が利用可能な情報及び一定の前提または仮定に基づくものであり、実際の業績等は、国内外の経済情勢、半導体市況、為替動向その他のリスク要因により、本資料に記載された将来情報と大きく異なる可能性があります。

また、本資料は、米国における証券の募集を構成するものではありません。米国 1933 年証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国内において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、米国 1933 年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。目論見書は、当該証券の発行会社又は売出人より入手することができますが、これには、発行会社及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。